

# UBMスパッタ装置



本装置は、マグネトロンスパッタリング蒸発源の磁場バランスを意図的に崩したアンバランスドマグネトロンスパッタリング(UBMS)方式の蒸発源を2台装備するとともに、アークイオンプレーティング(AIP)蒸発源を1台装備したマルチプロセス化に対応した成膜装置です。UBMS法によるダイヤモンドライクカーボン(DLC)膜、AIP法による各種硬質化合物膜の形成などが可能です。

制御用コンピューターシステムにより、装置本体の動作および制御が可能で、自動運転プログラムを作成して運転することにより、真空排気から加熱、ボンバード、コーティングプロセスを経て、基材の取り出しまでの一連の工程を全自動で行うことができます。

## (株)神戸製鋼所 UBMS202型

- ・主な仕様: 推奨処理空間 径200mm×高120mm(最大:径250mm×高さ270mm)、スパッタ蒸発源  $\phi$ 152mm×2台(最大3kW)、アークイオンプレーティング蒸発源  $\phi$ 100×1台(最大200A)、スパッタ電源 パルスDC出力モード付DC電源(最大1000V、30kHz)、ワークテーブル 一軸回転方式または3軸遊星回転方式
- ・機器使用料金: 1日51,900円(指導料別途要)
- ・問い合わせ先: 三浦(2651)、小畠(2718)